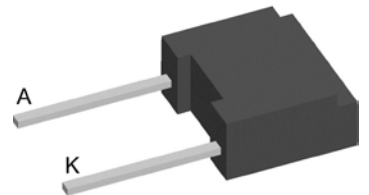


Breakover Diode Gen² (BOD2)

$$V_{BO} = 400-1400 \text{ V}$$

$$I_{AVM} = 0.9 \text{ A}$$

| V_{BO} [V] | Standard Types |
|-----------------|----------------|
| 400 ±50 | IXBOD2-04 |
| 500 ±50 | IXBOD2-05 |
| 600 ±50 | IXBOD2-06 |
| 700 ±50 | IXBOD2-07 |
| 800 ±50 | IXBOD2-08 |
| 900 ±50 | IXBOD2-09 |
| 1000 ±50 | IXBOD2-10 |
| 1100 ±50 | IXBOD2-11 |
| 1200 ±50 | IXBOD2-12 |
| 1300 ±50 | IXBOD2-13 |
| 1400 ±50 | IXBOD2-14 |



Backside: isolated



Features / Advantages:

- Extra fast turn-on
- Very low temperature dependence

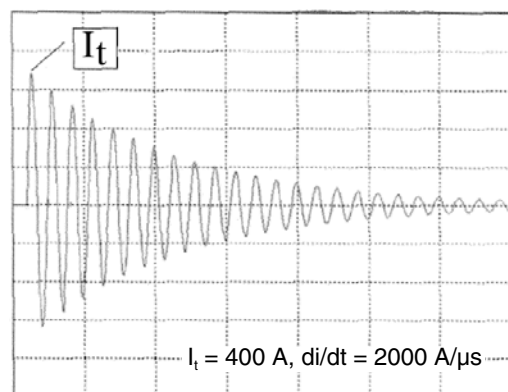
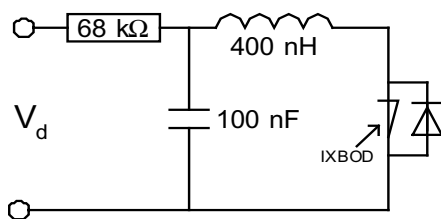
Applications:

- High voltage circuit protection
- Transient voltage protection
- Trigger device
- Power pulse generators
- Lightning and arcing protection
- Energy discharge circuits
- Battery overvoltage protection
- Solar array protection

Package: FP-Case

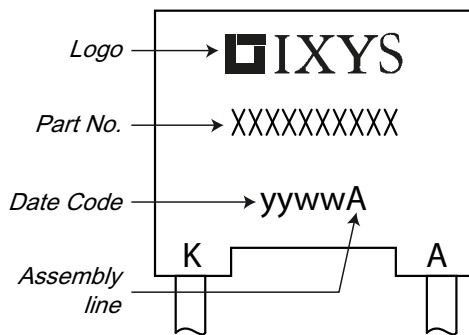
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

| BOD2 | | | Ratings | | | |
|----------------|---|--|---------|------|------------------------|--------------------------|
| Symbol | Definitions | Conditions | min. | typ. | max. | |
| I_D | drain current | $V_D = 0.8 \cdot V_{BO}$ | | | 10 200 | μA μA |
| V_{BO} | breakover voltage | $V_{BO}(T_{VJ}) = V_{BO, 25^\circ C} [1 + K_T (T_{VJ} - 25^\circ C)]$ | | | | V |
| I_{RMS} | RMS current | f = 50 Hz pins soldered to printed circuit (conductor 0.035x2mm) | | | 1.4 | A |
| I_{FAVM} | maximum average forward current | | | | 0.9 | A |
| I_{SM} | maximum pulsed source current | $t_p = 0.1$ ms; non repetitive | | | 250 | A |
| I^2t | I^2t value for fusing | $t_p = 0.1$ ms | | | 3.1 | A ² s |
| K_T | temperature coefficient of V_{BO} | | | | 0.7 · 10 ⁻³ | K ⁻¹ |
| K_P | coefficient for energy per pulse EP (material constant) | | | | 700 | K/Ws |
| R_{thJA} | thermal resistance junction to ambient | natural convection with air speed 2 m/s | | | 60 45 | K/W K/W |
| I_{BO} | breakover current | | | | 15 6 | mA mA |
| I_H | holding current | | | | 20 12 | mA mA |
| V_H | holding voltage | | 4 | | 8 | V |
| $(dv/dt)_{cr}$ | critical rate of rise of voltage | $V_D = 0.9 \cdot V_{BO}$ | | | 3000 1000 | V/ μs V/ μs |
| $(di/dt)_{cr}$ | critical rate of rise of current | $I_T = 100$ A; $V_D = V_{BO}$; f = 50 Hz $I_T = 600$ A; non repetitive | | | 200 500 | A/ μs A/ μs |
| t_q | turn-off time | $V_D = 0.75 \cdot V_{BO}$; $V_R = 0$ V; $I_T = 100$ A $dv/dt_{(lin.)} = 5000$ V/ μs ; $di/dt = -500$ A/ μs | | 200 | | μs |
| V_T | forward voltage drop | $I_T = 10$ A | | | 1.3 1.2 | V V |
| V_{T0} | threshold voltage | | | | 0.75 | V |
| r_T | slope resistance | for power-loss calculation only | | | 0.05 | Ω |



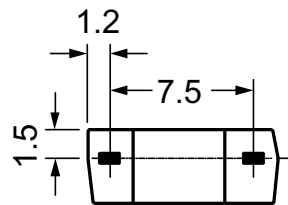
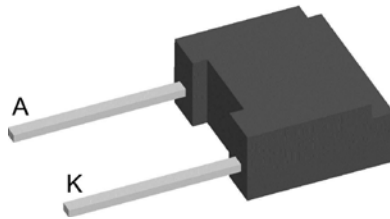
| Package FP-Case | | | Ratings | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------|---------|------|--------|
| Symbol | Definitions | Conditions | min. | typ. | max. |
| T_{amb} | ambient temperature (cooling medium) | | -40 | | 150 °C |
| T_{stg} | storage temperature | | -40 | | 150 °C |
| T_{vJM} | maximum virtual junction temperature | | -40 | | 150 °C |
| Weight | | | | 0.9 | g |

Product Marking

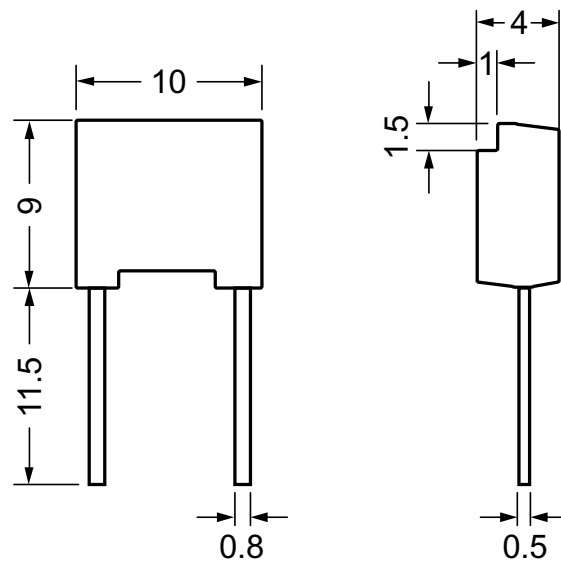


| Ordering | Part Name | Marking on Product | Delivering Mode | Base Qty | Ordering Code |
|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------|---------------|
| Standard | IXBOD2-04 | IXBOD2-04 | Box | 100 | 511174 |
| Standard | IXBOD2-05 | IXBOD2-05 | Box | 100 | tdb |
| Standard | IXBOD2-06 | IXBOD2-06 | Box | 100 | tdb |
| Standard | IXBOD2-07 | IXBOD2-07 | Box | 100 | 508425 |
| Standard | IXBOD2-08 | IXBOD2-08 | Box | 100 | 507602 |
| Standard | IXBOD2-09 | IXBOD2-09 | Box | 100 | 511668 |
| Standard | IXBOD2-10 | IXBOD2-10 | Box | 100 | 508078 |
| Standard | IXBOD2-11 | IXBOD2-11 | Box | 100 | 511860 |
| Standard | IXBOD2-12 | IXBOD2-12 | Box | 100 | 511675 |
| Standard | IXBOD2-13 | IXBOD2-13 | Box | 100 | 511682 |
| Standard | IXBOD2-14 | IXBOD2-14 | Box | 100 | 509782 |

Outlines FP-case



Dimensions in mm
(1 mm = 0.0394")





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.